



Laserový označovací a gravírovací systém
Sistema di marcatura e incisione laser

Flexibilita . Flessibilità

Kombinácia znalostí o procese a potrebách aplikácie s konštrukčnými vlastnosťami robia z BSP inovatívny systém pre jednoduchosť a produktivitu. Rozsah zdrojov od 20 do 100 W umožňuje vykonávať gravírovanie, značenie, opracovanie povrchu a mikrorezanie zosúladené s najvyššími dostupnými normami.

La conoscenza del processo e delle necessità applicative abbinate alle caratteristiche costruttive fanno di BSP un sistema innovativo per semplicità e produttività. La gamma di sorgenti da 20 a 100W permette di eseguire processi di incisione, marcatura, lavorazioni superficiali e micro-taglio allineati con i più alti standard che lo stato dell'arte tecnologico permette.

Kompaktný systém . Sistema compatto

BSP má kompaktnú a pevnú konštrukciu vďaka žulovej pracovnej roviny, ktorá zaručuje vynikajúcu stabilitu procesu pri kusoch s hmotnosťou do 20 kg. Základná konštrukcia obsahuje 3 motorizované osi s presnosťou pohybu 50 µm, zdvihom v roviny 300 x 300 mm a amplitúdou pozdĺž osi Z 300 mm. Môže byť vybavená radom príslušenstva, ako je rotačné alebo otočné vreteno, dynamické meracie systémy a systémy videnia.

BSP presenta una struttura compatta e solida grazie al piano di lavoro in granito, che garantisce un'ottima stabilità di processo e una tenuta fino ai 20 kg di peso. La struttura base include 3 assi motorizzati con precisione di movimento di 50 µm, corsa sul piano di 300 x 300 mm e un'ampiezza lungo l'asse Z che raggiunge i 300 mm. Può essere equipaggiato con accessori come il mandrino rotante o roto-tiltante, il tastatore dinamico e i sistemi di visione.

Pokročilý softvér . Software avanzato

Integrovaný softvér, ktorý kompletne vyvinula spoločnosť SISMA, je ideálnym riešením na správu súborov a celého procesu označovania, a to aj v prípade zložitých úloh: umožňuje plne využiť celý potenciál systému BSP PICO a zaručuje vysoký stupeň prispôsobenia na urýchlenie a zjednodušenie práce operátora.

Interamente sviluppato da SISMA, il software integrato è la soluzione ideale per la gestione dei file e del processo di marcatura, anche nel caso di lavorazioni complesse: permettendo di sfruttare appieno le potenzialità di BSP, garantisce un alto grado di personalizzazione per velocizzare e semplificare il lavoro dell'operatore.



Technické údaje – Dati tecnici

200F EP

300F

500F

1000F

Active material - Materiale attivo	Yb	Yb	Yb	Yb
Priemerný výkon - Potenza di uscita	20 W	30 W	50 W	100 W
Vlnová dĺžka - Lunghezza d'onda	1064 nm	1064 nm	1064 nm	1064 nm
Pracovná frekvencia - Frequenza di lavoro	1 ÷ 1000 kHz	1 ÷ 500 kHz	1 ÷ 1000 kHz	1 ÷ 4000 kHz
Trvanie impulzu - Durata impulso	3 - 500 ns	26 - 250 ns	6 - 500 ns	4 - 2000 ns
Maximálny výkon - Potenza di picco	> 10 kW	> 10 kW	> 10 kW	> 10 kW
Energia impulzu - Energia di impulso	> 1 mJ	> 1 mJ	> 1 mJ	> 1,2 mJ
Kvalita lúča - Qualità del fascio (M ²)	< 1,6	< 1,6	< 1,6	< 1,6
Chladiaci systém - Raffreddamento	Air / aria	Air / aria	Air / aria	Air / aria
Zdvoh osi (XYZ) - Corsa assi (XYZ)	300 mm x 300 mm x 300 mm			
Max hmotnosť kusu - Peso max pezzo	20 kg			
Presnosť - Precisione	0,05 mm			
Opakovateľnosť - Ripetibilità	0,02 mm			
Zdroj napájania - Alimentazione	230 V ± 15% 50/60 Hz - single phase - CEE 16A zásuvka / presa			
Absorpcia výkonu - Potenza assorbita	1 kW			
Rozmery (Dx H x V) - Dimensioni (L x P x A)	823 mm x 1329 mm x h 1904 mm (h 2400 mm s otvorenými dverami - con porta aperta)			
Hmotnosť - Peso	590 kg			

Funkcie, obrázky, výkony, hmotnosti a miery uvedené v katalógu sú úplne orientačné a približné a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Le caratteristiche, le immagini, le prestazioni, i pesi e le misure indicate si intendono del tutto indicativi ed approssimativi e possono variare senza preavviso.

10-2020